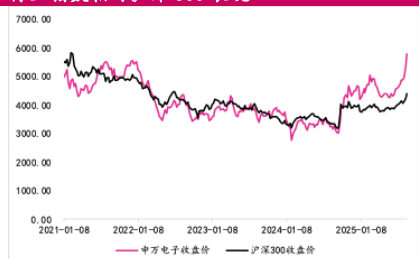


电子行业

2025年8月24日

涨幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
科森科技	15.26	61.14	84.67
盛科通信-U	130.00	43.95	533.00
芯原股份	149.82	41.79	787.62
南亚新材	75.75	39.48	177.84
成都华微	47.04	36.23	299.57
跌幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
久量股份	30.75	-10.90	49.20
威尔高	55.90	-10.62	75.25
冠石科技	56.82	-9.91	41.74
福日电子	15.92	-9.03	94.40
可立克	16.71	-7.17	83.00

行业指数相对沪深300表现



相关报告

【金元电子】周报 20250719 台积电 Q3 指引超预期、AI 与先进制程成增长双引擎

【金元电子】周报 20250725 世界人工智能大会，昇腾 384 超节点引领 AI 算力新纪元

【金元电子】周报 20250801 中美芯片博弈再升级，关注 H20 安全审查背后的国产替代机遇

【金元电子】周报 20250808 “China for China”战略已成为全球半导体产业的重要趋势

【金元电子】周报 20250808 光刻国产替代从 0 至 1 的“蓝海”，AI 基础设施投入的“红海”均值得关注

分析师：唐仁杰

执业证书编号：S0370524080002

电话：0755-83025184

邮箱：tangrj@jyzq.cn

行业周度点评报告

—DeepSeek 迎来第二次“杰文斯效应”，应用侧或加速落地

评级：增持（维持）

- **全行业：**本周上证指数上涨3.49%，深证成指上涨4.57%，沪深300指数上涨4.18%，申万电子版块上涨8.95%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为2/31。板块个股涨幅前五名分别为：科森科技、盛科通信-U、芯原股份、南亚新材、成都华微；跌幅前五名分别为：久量股份、威尔高、冠石科技、福日电子、可立克。
- **电子行业：**本周从申万二级行业数据维度看，半导体板块以12.26%的显著周涨幅领跑电子行业。其细分申万三级行业中，数字芯片设计子板块凭借16.36%的亮眼涨幅，成为半导体板块乃至整个电子行业的增长亮点；半导体设备子板块也有12.31%的可观涨幅。消费电子板块紧随其后，实现8.26%的周涨幅，消费电子零部件及组装子板块涨幅8.64%，品牌消费电子子板块涨幅5.28%。光学光电子板块周涨幅达7.13%，光学元件子板块8.74%涨幅表现突出，推动板块发展。电子化学品板块周涨幅5.29%，电子化学品III子板块同步实现5.29%涨幅。其他电子板块取得6.61%周涨幅，与电子化学品板块表现协同。元件板块本周虽以1.68%涨幅在二级行业中相对靠后，但印制电路板、被动元件等子板块也有不同程度上涨，为电子行业底层元件支撑贡献力量。
- **行业要闻**
 - ◆ 软银20亿美元入股英特尔，孙正义看好美国半导体制造前景
 - ◆ 英飞凌25亿美元收购Marvell汽车以太网业务落地
 - ◆ 中国放宽稀土出口限制，7月出口来到高点
 - ◆ Arm重金挖角亚马逊AI芯片专家，加速自研芯片计划
 - ◆ 英特尔与大型投资者洽谈以折扣价格增资入股
- **公司动态：**
 - ◆ 徕木股份：徕木股份2024年年度权益分派实施公告
 - ◆ 国瓷材料：关于公司2025年度中期现金分红方案的公告
 - ◆ 赛微电子：关于收购青岛展诚科技有限公司56.24%股权的公告
 - ◆ 莱特光电：莱特光电2025年半年度利润分配方案的公告
 - ◆ 长电科技：长电科技2025年中期利润分配方案的公告
- **投资建议：**我们认为，DeepSeek更新将是第二次“杰文斯效应”式的扩容。与DeepSeek V3/R1推出时相似，并非降低硬件门槛，而是单位资源可承载更长上下文、更复杂 Agent workflow、更高批量与并发。DeepSeek本次更新在软件层面大幅提升了推理及算力效率，应用侧的提效也值得期待，上市公司如鼎捷数智、海天瑞声、拓普农云、当虹科技、索辰科技、博思软件等或将受益。另外，随着国产算力+DeepSeek模型迭代致使端侧应用及国产垂态模型需求增大，端侧领域及AIDC领域值得，相关上市公司包括：端侧：瑞芯微、泰凌微、全志科技等；国产AIDC包括润泽科技、光环新网、奥飞数据等。
- **风险提示：**1、FP8编码在不同厂商间存在细微差异，MX的尺度/块大小虽有 OC P规范，但软硬实现细节仍需磨合，跨平台迁移可能产生再校准成本。2、先进制程及产能当前饱满，产能与订单或存在错配导致上市公司短期难以实现目标订单。3、全球AI算力需求增速可能放缓，若下游应用大模型、自动驾驶等商业化落地不及预期，或导致基础设施投入、先进制程需求减弱

目 录

一、核心观点3

二、行业跟踪6

三、行业新闻8

四、公司公告14

五、下周重要事件提示19

图表目录

图 1：MX 块级缩放原理3

图 2：E4M3/E5M2 精度及范围对比4

图 3：本周各行业版块涨跌幅6

图 4：本周电子版块：子版块涨跌幅7

图 5：电子版块历史走势8

图 6：电子版块历史市盈率8

表 1：本周电子版块个股涨幅前五名6

表 2：本周电子版块个股跌幅前五名6

表 3：下周重要会议19

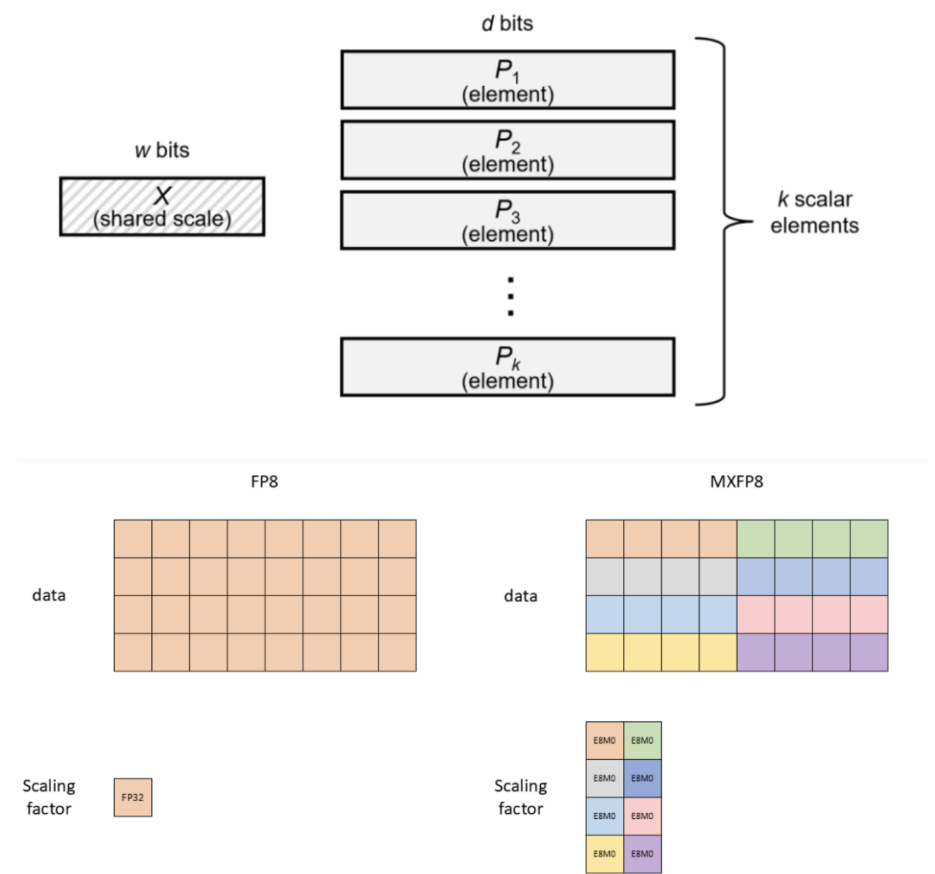
表 4：电子行业限售股解禁情况汇总（单位：万股）20

一、核心观点

DeepSeek 官宣 DeepSeek-V3.1 重大更新，DeepSeek-V3.1 使用了 UE8M0 FP8 Scale 的参数精度，并指出该精度配置面向“下一代国产芯片”。另外，本次更新实现思考模式与非思考模式的自由切换，相比于 DeepSeek-R1-0528, V3.1 的思考效率大幅提升，能够在更短时间内给出答案。

何为 UE8M0 FP8 Scale? UE8M0 FP8 实际是由两部分组成。首先，所谓 UE8M0，并非第三种 FP8 格式，而是 MX (Microscaling) 块级缩放的“Scale 格式”。把一个张量按固定小块切分(常见 $k=32$)，每块共享一个尺度 X ；在 MXFP8 下，尺度 X 用 E8M0 编码 (8 位指数、0 位尾数、无符号，只表示 2^k)，而块内的每个具体数值 P_i 仍用 E4M3 或 E5M2 的 FP8 表示。最终重构时，真实值 $v_i = X \times P_i$ 还原。因为 X 仅是 2^k ，硬件解码近似等价于指数位平移，路径短、功耗低；同时尺度元数据从传统 FP32 缩到 1 字节 (FP8)，元数据带宽显著下降。这一机制 OCP MX1.0 规范中被系统化定义，并明确 $MXFP8 = (E4M3/E5M2 \text{ 元素}) + (E8M0 \text{ 尺度}) + (k = 32)$ 。

图 1：MX 块级缩放原理

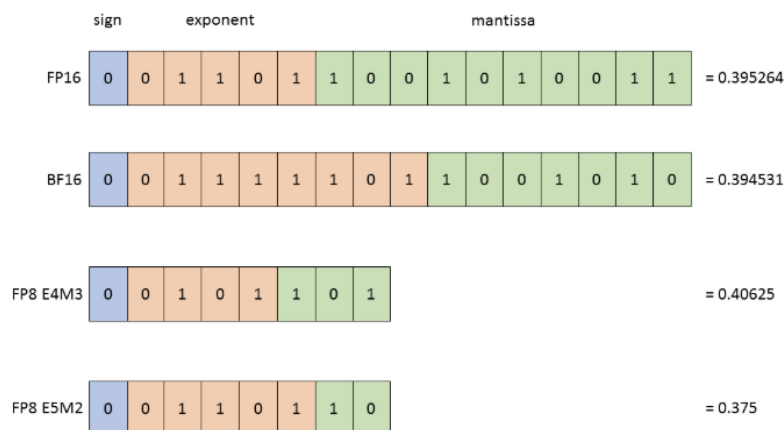


数据来源: Nvidia、金元证券研究所

与传统 E4M3/E5M2 FP8 的不同。UE8M0 是“尺子”(缩放因子)，E4M3/E5M2 是

“刻度”（元素值）。在一个 $k=32$ 的小块里，先用 UE8M0 选择合适的 2^k 尺度，把该块数据整体搬到“可用动态范围”的合适区间。再利用 E4M3 或 E5M2 把块内元素量化存储。E4M3 以更多尾数位换取更高精度，但指数位较少、范围较窄；E5M2 以更多指数位换取更大范围，但精度略逊。工程上常见“前向/权重偏 E4M3、反向/梯度偏 E5M2”的混合配方，兼顾稳定性与吞吐。

图 2：E4M3/E5M2 精度及范围对比



数据来源：Nvidia，金元证券研究所

严格来说，支持 UE8M0 分三层含义：存取格式支持、算子/内核支持、指令级/单元级原生支持。不改硬件的前提下，前两层可以通过软件栈做到不同程度的兼容，第三层难以兼容：

- **存取格式层**：即把模型权重/激活以“E8M0 尺度 + FP8 元素（或 INT8 元素）”组织起来。只要编译器/运行时在加载时把每块的 2^k 合并进元素（Float 是加指数，Int 是移位+饱和），就能复原为芯片原生支持的计算类型（例如 FP16/BF16/INT8），去执行后续 FMA（Fused Multiply - Accumulate）。这一步不需要改硬件，但需要在框架/驱动/编译器里实现“块级解码”的高效流水化（DMA/JIT 解码/寄存器打包等）。MX 规范还定义了 MXINT8（E8M0+INT8）的变体，理论上对只做 INT8 NPU 也能复用“ 2^k Scale”的解码逻辑
- **算子/内核层**：如果硬件没有原生 FP8 乘加与块尺度融合，那就只能在内核前后做“解码/回写”。解码若能在 on-chip SRAM/寄存器里完成（而非落到 DDR），仍可保留一部分带宽优势：在外存里存的是 FP8+1B 尺度，拉进片上再变成 FP16/INT8 去算。相反，如果解码发生在 CPU/GPU 上再写回 NPU，来回搬运可能抵消收益。
- **指令级/单元级原生支持**：比如像 NVIDIA Blackwell 把 MXFP8 作为一等数据类型，在张量核里把“块尺度解码 + FP8 FMA”合成一个执行路径；或像部分国产 GPU/NPU 宣称的“原生 FP8/Block-FP8”那样把尺度融合到矩阵核里。这一层必须改硬件。

下一代国产芯片值得期待，软硬协同推动为国产算力硬件创造时间与空间。

UE8M0 FP8 的本质，是用极低开销、硬件友好的“ 2^k 尺度”为每个小块数据

撑起动态范围的天窗，让 E4M3/E5M2 在更窄位宽下也能稳态运行。DeepSeek V3.1 把这一路线推向“国产硬件可承接”的实践场景——先在端侧吃下带宽/容量/能效的“确定性红利”，再向 AIDC 侧外溢为更高密度、更高吞吐的资源池。这不是抑制需求的降配，而是把“单位资源的价值”推上新台阶，从而让总量需求顺势放大。

我们认为，DeepSeek 更新将是第二次“杰文斯效应”式的扩容。与 DeepSeek V3/R1 推出时相似，并非降低硬件门槛，而是单位资源可承载更长上下文、更复杂 Agent 工作流、更高批量与并发时，企业侧的使用边际成本下降将带来总调用次数与更大模型/更复杂应用的扩张。效率提升最终转化为更大的算力与内存总量。DeepSeek 在产品层引入“混合推理结构、增强 Agent 能力”的策略，亦会将这种扩张呈现在“端侧分流 + 云侧加总”的协同形态上。除下一代国产芯片的落地外，我们认为 DeepSeek 本次更新在软件层面大幅提升了推理及算力效率，应用侧的提效也值得期待，上市公司如鼎捷数智、海天瑞声、拓普农云、当虹科技、索辰科技、博思软件等或将受益。另外，随着国产算力+DeepSeek 模型迭代致使端侧应用及国产垂态模型需求增大，端侧领域及 AIDC 领域值得，相关上市公司包括：端侧：瑞芯微、泰凌微、全志科技等；国产 AIDC 包括润泽科技、光环新网、奥飞数据等。

风险提示：

1、技术风险：

FP8 编码在不同厂商间存在细微差异，MX 的尺度/块大小虽有 OCP 规范，但软硬实现细节仍需磨合，跨平台迁移可能产生再校准成本。

2、国产算力芯片产能不及预期：

先进制程及产能当前饱满，产能与订单或存在错配导致上市公司短期难以实现目标订单。

3、市场需求波动：

全球 AI 算力需求增速可能放缓，若下游应用大模型、自动驾驶等商业化落地不及预期，或导致基础设施投入、先进制程需求减弱，影响营收增长。

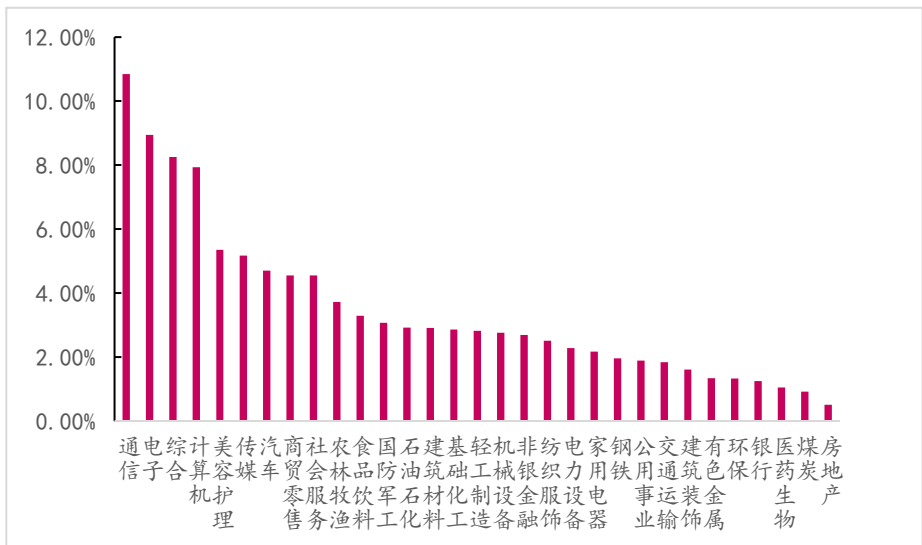
4 供应链风险：

半导体行业依赖全球供应链，地缘冲突、贸易摩擦或自然灾害可能导致关键设备、材料供应中断，影响产能释放。

二、行业跟踪

全行业：本周（2025.08.18-2025.08.22）上证指数上涨 3.49%，深证成指上涨 4.57%，沪深 300 指数上涨 4.18%，申万电子板块上涨 8.95%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为 2/31。板块个股涨幅前五名分别为：科森科技、盛科通信-U、芯原股份、南亚新材、成都华微；跌幅前五名分别为：久量股份、威尔高、冠石科技、福日电子、可立克。

图 3：本周各行业板块涨跌幅



数据来源：Choice，金元证券研究所

表 1：本周电子板块个股涨幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价（元）	周最低价（元）	周最高价（元）	周换手率	周成交量（万手）	周成交金额（亿元）
603626.SH	科森科技	61.14	15.26	10.42	15.26	82.54	458.01	61.04
688702.SH	盛科通信	43.95	130.00	87.00	134.00	24.43	49.23	52.28
688521.SH	芯原股份	41.79	149.82	104.32	158.75	30.09	150.68	207.33
688519.SH	南亚新材	39.48	75.75	59.88	81.42	34.02	79.87	53.53
688709.SH	成都华微	36.23	47.04	33.99	47.04	41.52	90.47	35.60

数据来源：Choice，金元证券研究所

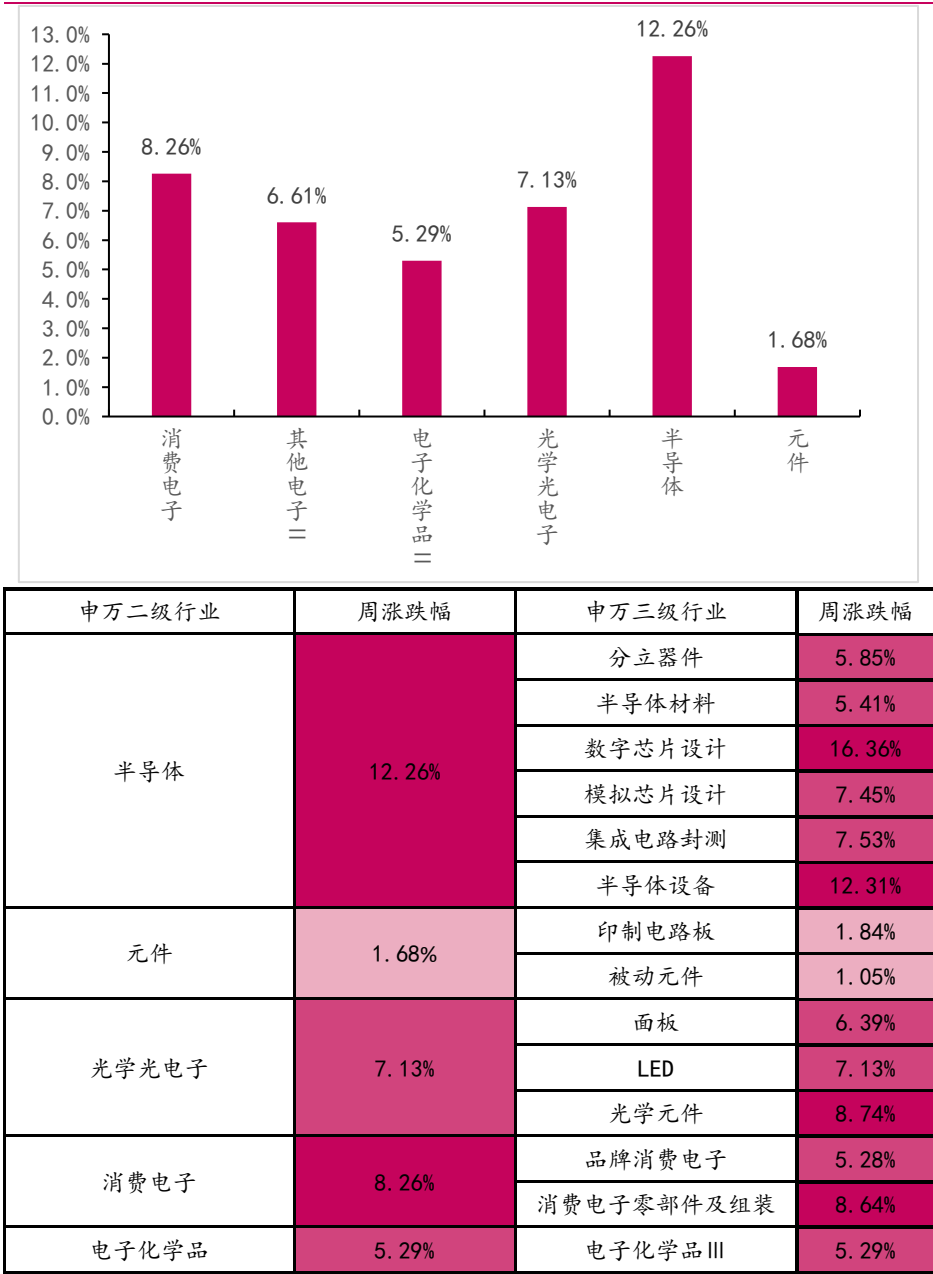
表 2：本周电子板块个股跌幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价（元）	周最低价（元）	周最高价（元）	周换手率	周成交量（万手）	周成交金额（亿元）
300808.SZ	久量股份	-10.90	30.75	30.13	34.77	30.24	31.81	10.09
301251.SZ	威尔高	-10.62	55.90	55.38	65.18	107.62	58.03	34.50
605588.SH	冠石科技	-9.91	56.82	54.00	69.37	56.52	41.32	24.77
600203.SH	福日电子	-9.03	15.92	15.08	18.61	149.26	885.08	148.63
002782.SZ	可立克	-7.17	16.71	16.25	18.95	45.18	219.80	38.43

数据来源：Choice，金元证券研究所

电子行业：本周（2025.08.18-2025.08.22）从申万二级行业数据维度看，半导体板块以12.26%的显著周涨幅领跑电子行业。其细分申万三级行业中，数字芯片设计子板块凭借16.36%的亮眼涨幅，成为半导体板块乃至整个电子行业的增长亮点；半导体设备子板块也有12.31%的可观涨幅。消费电子板块紧随其后，实现8.26%的周涨幅，消费电子零部件及组装子板块涨幅8.64%，品牌消费电子子板块涨幅5.28%。光学光电子板块周涨幅达7.13%，光学元件子板块8.74%涨幅表现突出，推动板块发展。电子化学品板块周涨幅5.29%，电子化学品III子板块同步实现5.29%涨幅。其他电子板块取得6.61%周涨幅，与电子化学品板块表现协同。元件板块本周虽以1.68%涨幅在二级行业中相对靠后，但印制电路板、被动元件等子板块也有不同程度上涨，为电子行业底层元件支撑贡献力量。

图 4：本周电子版块：子版块涨跌幅



其他电子	6.61%	其他电子Ⅲ	6.61%
------	-------	-------	-------

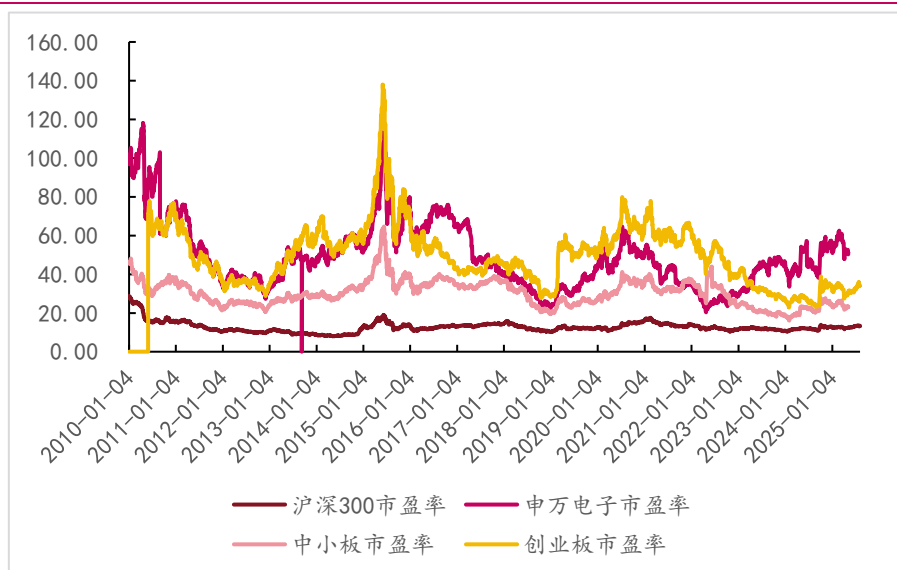
数据来源: Choice, 金元证券研究所

图 5: 电子板块历史走势



数据来源: Choice, 金元证券研究所

图 6: 电子板块历史市盈率



数据来源: Choice, 金元证券研究所

三、行业新闻

腾讯表示GPU库存充足暂不采购H20，推理转向非西方芯片

8月18日电子工程专辑消息，中国科技巨头腾讯控股在第二季度财报电话会议上，就AI芯片采购策略作出明确回应。总裁刘炽平表示，腾讯当前AI GPU芯片库存充足，可满足未来模型训练需求，暂无继续采购英伟达H20的计划。针对美国恢复对华出口H20及AMD MI308芯片的政策，腾讯强调其自主技术布局已形

成缓冲能力。刘炽平在会议上透露，腾讯已连续三个季度维持充足GPU库存，足以支撑现有模型升级及新一代“混元”大模型的研发。他特别指出，腾讯是全球最早订购英伟达H800芯片的企业之一，目前储备的H800芯片“足以再开发数代混元模型”。在推理端，腾讯已布局非西方芯片选项，包括评估境内合法获取的ASIC（专用集成电路）或GPU等加速器。刘炽平强调：“我们有许多方式可满足不断扩大的AI推理需求，不必一味依赖西方GPU。”

美国民主党参议员要求特朗普政府禁止英伟达、AMD对华出售AI芯片

8月18日电子工程专辑消息，近日，美国民主党6名参议员要求特朗普重新考虑允许英伟达对华出售AI芯片之举，这一问题涉及美国对华技术出口管制政策的争议。据悉，纽约州联邦参议员舒默、弗吉尼亚州联邦参议员沃纳、罗德岛州联邦参议员里德、新罕布什尔州联邦参议员沙欣、特拉华州联邦参议员库恩斯和马萨诸塞州联邦参议员沃伦签署一封公开信，旨在回应特朗普8月11日宣布的一项声明。今年4月，特朗普政府曾以“国家安全和经济安全”为由，禁止英伟达向中国销售H20芯片。不过，到8月，英伟达和AMD已与美国政府达成协议，同意将H20芯片和MI308芯片在中国市场销售收入的15%上缴美国政府，以换取对华市场的半导体出口许可。然而，这一协议引发了广泛的争议，包括法律、经济和政治层面的讨论。对于特朗普“允许科技巨头英伟达和AMD向中国出售人工智能芯片，并换取其15%销售收入分成的决定”，该公开信强调：“我们的国家安全和军事准备依赖于美国创新者发明和生产世界上最先进的技术，并在敏感领域保持这种质量优势。美国历史上之所以能够成功地保持和建立这种优势，部分原因在于我们有能力阻止敌手们获取这些技术”。

莫迪宣布印度首款国产芯片年底问世

8月18日电子工程专辑消息，印度半导体产业的规划可追溯到半个世纪前，但当时的计划长期停滞，导致印度在关键产业链上落后数十年。2021年，韦丹塔集团（Vedanta）与富士康合资的半导体项目因技术转让和资金问题搁浅，导致印度首次大规模芯片制造计划失败。2023年，印度政府重启半导体激励计划，推出总额100亿美元的“半导体使命”（Semicon India Programme），吸引国际厂商合作。8月15日，印度总理纳伦德拉·莫迪在第79届独立日庆典上宣布，印度首款自主研发的芯片将于2025年底前正式进入市场。莫迪表示：“21世纪将由科技驱动，谁掌握了科技，谁就能发展上达到新的高度。而印度这半个世纪在半导体领域的文件和计划一直被搁置，对比其他走在世界前列的半导体前沿国家，我们已经被时代淘汰”。莫迪还强调，当前他们已经摆脱了历史包袱，以“任务模式”推进半导体产业建设，目前已有六个芯片项目正在建设，另还有四个项目刚刚获批立项。这些项目建设在古吉拉特邦、阿萨姆邦和北方邦等地，联合信息科技部长 Ashwini Vaishnaw 表示，这些设施将很快产出印度首款“印度制造”芯片。

川普扬言课征300% 芯片关税

8月19日科技新报消息，美国总统川普扬言要对芯片课征300% 进口关税，但分析人士认为，已经赴美设厂的台积电及其客户不必太过担忧。路透社、Yahoo Finance、MarketWatch等外电报导，川普上周五飞往阿拉斯加跟俄罗斯总统普京会面时，于空军一号对记者表示，他会在数周后开始对钢铁与芯片和

半导体课征关税。川普先前就曾暗示，他准备将芯片关税设定在100%左右。他周五又提出更为夸大的数字，称“税率可能会来到200%、300%”，并表示一开始的芯片税率会较低，让业者有机会前来美国设厂，但一段时间后税率就会拉到非常高。

英飞凌25亿美元收购Marvell汽车以太网业务落地

8月19日电子工程专辑消息，英飞凌宣布完成对Marvell汽车以太网业务的收购，该交易于2025年4月宣布，并已获得所有必要的监管批准。交易协议于2025年4月宣布，预计将在2025年内完成。此次收购旨在增强英飞凌在软件定义汽车领域的系统能力，并进一步巩固其在汽车应用微控制器领域的领先地位。交易涉及以25亿美元的现金收购Marvell的汽车以太网业务。该业务预计将为英飞凌带来可观的收入和利润增长，预计2025年的收入为2.25亿至2.5亿美元，毛利率约为60%。此外，此次收购将使英飞凌能够提供更全面的解决方案，结合其领先的汽车微控制器产品组合与Marvell的汽车以太网业务，加速软件定义汽车的转型。

华虹半导体拟收购华力微，解决同业竞争

8月19日电子工程专辑消息，国内半导体龙头华虹半导体有限公司于今日发布重大资产重组公告，拟通过发行股份及支付现金的方式收购上海华力微电子有限公司控股权，并配套募集资金。资料显示，华虹半导体和华力微都属于华虹集团旗下资产，其中华力微电子的资产主要为华虹五厂和华虹六厂。华虹五厂成立于2010年，是一座8英寸晶圆厂，主要覆盖55-28nm工艺节点，月产能约3.8万片；华虹六厂是一座12英寸晶圆厂，主要覆盖28nm-14nm制程。此次交易旨在解决双方在65/55nm及40nm工艺节点上的同业竞争问题，标的资产为华力微旗下运营相关工艺的华虹五厂股权。公司股票自8月18日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。2023年8月华虹公司登陆科创板时，其间接控股股东上海华虹(集团)有限公司曾出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》，承诺“自发行人上市之日起三年内，按照国家战略部署安排，在履行政府主管部门审批程序后，将华力微注入发行人”。

Advent开13 亿美元，拟收购瑞士芯片制造商U-blox

8月19日科技新报消息，安宏资本计划出价收购瑞士定位芯片制造商U-blox，交易金额约为10.5 亿瑞士法郎（约13 亿美元）。Advent 现金收购价为每股135 瑞士法郎。在彭博社报道后，U-blox 股价一度大涨20%，创下自2022 年8 月以来最大单日涨幅，今年已涨约77%、市值突破12 亿美元。瑞士定位芯片制造商U-blox 则回应，目前正与Advent 收购交易进行谈判中。私募股权公司近期积极布局欧洲公开市场，认为当前的市场估值未能反映企业基本面。近期Nordic Capital 与Permira 联盟针对丹麦上市的疫苗制造商Bavarian Nordic A/S 提出收购案。若能成功收购U-blox，将是Advent 在欧洲市场的另一宗公开收购案。此前，Advent 曾寻求收购伦敦上市的Spectris Plc 以及义大利的Tinexta SpA。

首款微波芯片，人工智能与无线通讯的革命性突破

8月19日科技新报消息，康乃尔大学Bal Govind 与Maxwell Anderson 等团队

11 日于《Nature Electronics》期刊发表全球首款“微波大脑”芯片，突破性采用可调微波波导取代传统数位逻辑闸，实现数10G赫兹高速资料处理与类神经网络运算，功耗低于200 毫瓦，是现有数位芯片功耗的数分之一。这款实验性芯片设计与传统截然不同。传统芯片靠时钟驱动的二进位逻辑闸逐步处理数据，康乃尔大学则用可调微波波导推动讯息流动，让数据模式即时出现并辨识，速度可达数10G赫兹，明显降低能耗并提升速度，为小型设备随时可用、无需云端的AI铺路。每个波导就像一个“物理神经元”，微波讯号幅度、相位和频率可调整以显示数据特征。这些特征在类比领域相互作用和干扰，产生丰富模式，讯号数位化前就形成。物理混合传播过程，其实执行数位网路通常需经多层软体完成特征提取和转换。

软银砸20亿美元入股英特尔，成为第五大股东

8月20日科技新报消息，英特尔与软银周一（18 日）共同宣布，将获得软银20 亿美元投资。根据联合声明，软银将以每股23 美元购买英特尔普通股。双方形容此协议为“深化对美国芯片创新的承诺”，并将依惯例完成交割条件。英特尔周一股价以每股23.66 美元作收，消息出来后，盘后股价上涨约6%，至每股25 美元。英特尔执行长陈立武在声明中表示，“我和Masa（孙正义）已经合作数十年，我很感谢他透过这项投资对英特尔展现的信任。”根据FactSet数据，这笔投资使软银成为英特尔第五大股东，也是对英特尔一种支持表态。该公司去年重挫60%，创半个多世纪以来在公开市场的最差表现。截至周一收盘，英特尔今年股价已经反弹18%。陈立武今年3 月接任英特尔执行长，但先前美国总统川普曾呼吁他下台。

中国放宽稀土出口限制，7月出口来到高点

8月20日电子时报消息，中国稀土出口持续复苏。美国总统川普在4月初提出关税政策后，中国政府随即以限制稀土出口作为反制措施，影响全球供应链。彭博数据显示，2025年7月，中国稀土出口已经接近1月时的高位。出口成长达69%，有6,422吨。北京恢复稀土出口，是与华盛顿贸易休战协议的一环。全球有90%的稀土磁铁为中国生产，4月初中国开始管制出口，让印度、欧洲以及美国等业者难以取得，甚至导致部分车厂一度停产。5月时，中国稀土出口将至低点。美国国防部则在7月公布与本土业者MP Materials的合作计划，目标提升本土供应量。美国贸易代表Jamieson Greer日前表示，中国会将稀土供应恢复至限制之前的水平，“已经完成一半”。

2纳米代工战开打，三星主打低价抢客策略

8月20日电子时报消息，2纳米制程竞争已拉开序幕，三星电子（Samsung Electronics）在赢得Tesla大单后，正试图以相对较低的价格、快速应对的能力，持续争取新客户；相较之下，台积电2纳米制程预计采用高价策略，且“不打折、不议价”。大致而言，2纳米在相同功耗下可提升10~15%的效能，或在相同效能下节省20~30%电力，对于AI、伺服器、行动装置等产业，是极具吸引力的选项。韩媒Ddaily报导指出，三星主打“价格竞争力”来争取客户。据悉，目前三星2纳米良率约在40%水准，稳定进度虽晚于台积电，但三星为恢复技术信赖度、确保参考案例，正以相对低的价格与快速应对力，吸引新客户。近日，三星取得23兆韩元规模的Tesla晶圆代工订单，即是代表案例。三星此次

被选为Tesla下一代AI芯片“AI6”的生产伙伴，被认为是价格竞争力、供应灵活获得认可。部分南韩观点期待，三星2纳米产线也可能获得苹果（Apple）、Meta等高阶客户部分订单。

Arm重金挖角亚马逊AI芯片专家，加速自研芯片计划

8月20日电子时报消息，软银集团旗下芯片设计公司Arm宣布，已成功聘请亚马逊人工智能芯片部门主管拉米·辛诺（Rami Sinno），他将担任Arm的关键领导职务，全力推动其自研完整芯片的战略计划。这一重磅人事任命标志着Arm正从传统的芯片知识产权（IP）授权商业模式，向自主设计和制造完整芯片的战略方向加速转型，旨在抓住AI计算市场爆发性增长的战略机遇，强化自身竞争力。拉米·辛诺是业界知名的AI芯片专家，在亚马逊任职期间主导开发了自研AI芯片Trainium和Inferentia，这些芯片专为构建和运行大规模人工智能应用程序而设计，他的技术和经验将对Arm自研芯片项目起到至关重要的作用。为了吸引这位顶尖人才，Arm提供了极具竞争力的薪酬方案，包括500万美元的现金年薪、价值约2000万美元的限制性股票单位（RSU），以及一份与未来产品路线图达成情况挂钩的长期绩效奖金计划。

英伟达拟自研HBM弥补短板，3nm工艺，2027H2小规模试产

8月20日电子工程专辑消息，英伟达拟自研HBM内存Base Die，采用3nm工艺，计划于2027年下半年开始小规模试产，以弥补HBM这一短板。这一时间点大致对应“Rubin”后的下一代AI GPU “Feynman”。英伟达未来的HBM内存供应链将采用内存原厂DRAM Die+英伟达Base Die的组合模式。这一计划标志着英伟达在高性能计算存储架构领域的垂直整合深化，未来所有HBM堆叠产品将使用英伟达自研方案，以优化AI芯片内存带宽与能效匹配度。HBM（高带宽内存）已成为制约AI芯片性能的“存储墙”关键因素。随着AI芯片对内存带宽和容量的需求不断增长，HBM技术也在不断迭代。从英伟达A100到Blackwell Ultra系列产品，HBM不仅在材料清单（BOM）中的成本占比已超过50%，而且绝对和相对增长的最大部分均来自HBM。目前，HBM市场主要由SK海力士、三星、美光等头部供应商主导，其中SK海力士占据最高市占率。

DeepSeek透露下一代国产芯片即将发布

8月21日IT之家消息，深度求索官方今日正式对外发布 DeepSeek-V3.1，官方提到 DeepSeek-V3.1 使用了 UE8M0 FP8 Scale 的参数精度。在 DeepSeek 官方公众号文章页面，DeepSeek 进一步解释称，UE8M0 FP8 是针对即将发布的下一代国产芯片设计。DeepSeek V3.1 的 Base 模型在 V3 的基础上重新做了外扩训练，一共增加训练了 840B tokens。Base 模型与后训练模型均已在 Huggingface 与魔搭开源。

DeepSeek-V3.1 正式发布，官方详解迈向 AI Agent 时代的第一步

8月21日IT之家消息，深度求索官方今日正式对外发布 DeepSeek-V3.1。本次升级包含以下主要变化：在混合推理架构方面，一个模型同时支持思考模式与非思考模式；更高的思考效率，相比 DeepSeek-R1-0528，DeepSeek-V3.1-Think 能在更短时间内给出答案；更强的 Agent 能力：通过 Post-Training 优化，新模型在工具使用与智能体任务中的表现有较大提升。官方 App 与

网页端模型已同步升级为 DeepSeek-V3.1。用户可以通过“深度思考”按钮，实现思考模式与非思考模式的自由切换。DeepSeek API 也已同步升级，deepseek-chat 对应非思考模式，deepseek-reasoner 对应思考模式，且上下文均已扩展为 128K。同时，API Beta 接口支持了 strict 模式的 Function Calling，以确保输出的 Function 满足 schema 定义。另外，深度求索增加了对 Anthropic API 格式的支持，让用户可以将 DeepSeek-V3.1 的能力接入 Claude Code 框架。

挑战SK海力士，消息称三星HBM4样品已通过英伟达测试，本月预生产

8月21日IT之家消息，据韩媒 SEDaily 昨天报道，据半导体业界消息，三星上月提供给英伟达的 HBM4 样品已通过初期测试和质量测试，将在本月底进入“预生产”阶段。SEDaily 表示，HBM4 芯片将被应用在英伟达的下一代 AI 加速器“Rubin”中。目前英伟达 HBM 芯片的独家供应商是 SK 海力士，其在今年 3 月已交付 HBM4 样品，并于 6 月初提供初期量产品，计划在 10 月进入大规模量产。如果三星能顺利通过预生产阶段，他们的 HBM4 芯片在 11 月就能开始量产，从而迅速缩小与 SK 海力士之间的差距。

Meta发言人回应AI部门暂停招聘，仅为组织架构调整

8月21日IT之家消息，Meta 发言人 Andy Stone 今天在 X 平台回应了《华尔街日报》关于公司 AI 部门停止招聘的一些传闻。回应中他以略带调侃的语气表示，《华尔街日报》很努力地把枯燥的事情讲得很刺激，但 Meta 其实只是在进行基础操作，吸纳新人后为新的 AI 项目建立一个稳固架构，并进行年度预算和规划。Andy 随后表示，公司只是在进行一些基本的组织规划调整，在新的 AI 项目建立架构期间，将暂停部分招聘，此前公司已经引入了多名新成员加入团队。

英特尔正与其它大型投资者谈判，欲复刻软银“优惠价入股”融资合同

8月21日IT之家消息，美媒 CNBC 当地时间 20 日援引消息人士的话报道称，英特尔正与其它大型外部投资者展开融资谈判，希望达成与此前软银交易类似的合同。英特尔与软银在 8 月 18 日本周一共同宣布，软银以每股 23 美元购买英特尔的普通股，通过这一方式向英特尔投资 20 亿美元（IT之家注：现汇率约合 143.65 亿元人民币）。而英特尔股票本周一的开盘价为每股 23.9 美元。除机构投资者外，美国政府还计划将向英特尔提供的《CHIPS》法案补贴转换为约 10% 的无投票权股份。

英特尔首个机架级AI芯片，Jaguar Shores样品曝光，18A工艺+HBM4内存

8月21日IT之家消息，科技媒体 WccfTech 报道称英特尔新一代 AI 芯片“Jaguar Shores”测试样品曝光，该芯片采用 18A 工艺和 HBM4 高带宽内存，封装尺寸高达 92.5 毫米 x 92.5 毫米，支持机架级部署。“Jaguar Shores”是一款面向数据中心和企业级应用的产品，主要为 AI 推理和训练任务提供强劲算力支持，将采用先进的 18A 制程工艺，并集成最新一代 HBM4 高带宽内存。该芯片封装尺寸达 92.5 毫米 x 92.5 毫米，测试板上集成了四个计算芯片块和八组 HBM 存储接口，具备强悍的数据吞吐能力。“Jaguar Shores”被定位为英特尔首个机架级AI平台，有望与英特尔即将发布的 Diamond

Rapids Xeon 服务器处理器协同工作，支持企业级和云端 AI 工作负载。

SK海力士压力山大，三星HBM4 传获英伟达验证通过

8月22日科技新报消息，韩媒传出，三星电子（Samsung Electronics）的第六代高频宽内存“HBM4”样本已获得英伟达（Nvidia Corp.）验证通过，预计8月底便可进入最终的预生产（pre-production, PP）阶段，若测试顺利，则最快今年底便能开始量产。BusinessKorea、Wccftech 21日引述首尔经济日报报导，一名业界人士透露，据了解三星HBM4的各种品质项目（包括良率等）皆获得正面评价，目前已进入预生产阶段。“若预生产测试也通过，估计11月或12月就可量产”。预生产是半导体量产前的最后验证程序。三星7月提供的HBM4原型是一款“工程样本”，而预生产程序会测试样本跟客户绘图处理器（GPU）的相容性，看看在特定温度环境下，品质能否达到高标。一旦通过这个阶段，便可转入量产期。HBM4将应用于英伟达次世代AI加速器“Rubin”。

英特尔与大型投资者洽谈以折扣价格增资入股

8月22日科技新报消息，美国财经媒体CNBC 报导，知情人士指出，英特尔（Intel）正在与其他大型投资者洽谈，商讨以折扣价格增资入股的可能性。日本软银集团（SoftBank Group Corp.）本周稍早宣布将投资20亿美元入股英特尔，以及外传美国政府正在考虑以不同方式入股英特尔之后，英特尔股价一度反弹，但今天跌逾7%。美国商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）20日接受CNBC采访时表示，美国政府必须以获得英特尔的股权作为提供“芯片法”（CHIPS Act）资金的交换条件。知情人士指出，英特尔目前正寻求软银之外的其他大型投资者来获得增资。在经历多年销售下滑与市场占有率萎缩后，英特尔正试图进行转型与重振。

中国光伏行业协会倡议，坚决抵制以低于成本的价格开展恶性竞争

8月22日IT之家消息，中国光伏行业协会今日发文，光伏行业是我国具备全球领先优势的战略性新兴产业，是全面落实“碳达峰、碳中和”目标的重要力量。近期，受各方面复杂因素影响，行业供需矛盾突出、市场无序竞争加剧，严重阻碍了产业高质量发展进程。综合整治“内卷式”竞争，事关国家和产业发展大局，光伏行业将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实加强行业自律，共同维护公平竞争、优胜劣汰的市场秩序。

四、公司公告

瑞芯微：关于调整股票期权行权价格、限制性股票回购价格的公告

公司8月18日发布公告，根据《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《瑞芯微电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《瑞芯微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若激励对象在股票期权行权前/获授的限制性股票完成股份登记后，公司有派息事项，应分别对股票期权的行权价格/尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。因此，公司对相关激励计划的行权价格、回购价格进行调整。股票期权行权价格由 137.67 元/份

调整为 137.02 元/份。本次股票期权行权价格、限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及各期股权激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

徕木股份:徕木股份2024年年度权益分派实施公告

公司8月18日发布公告，本次利润分配以权益分派股权登记日的公司A股总股本 426,810,818 扣减回购专用证券账户中的股份 3,740,516 股后的股份 423,070,302 股为基数，向全体A股股东每股派发现金红利 0.027 元，共计派发现金红利 11,422,898.15 元。如在实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项导致公司可参与分配股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

芯动联科:关于2025年中期利润分配预案的公告

公司8月18日发布公告，根据安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度财务报告（未经审计），截至2025年6月30日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为154,322,510.31元，母公司可供分配利润为人民币531,475,695.15元。经董事会决议，公司本次利润分配预案如下：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.56元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为400,715,660股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币62,511,642.96元（含税）。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为40.51%。本半年度不进行公积金转增股本，不送红股。

国瓷材料:关于公司2025年度中期现金分红方案的公告

公司8月18日发布公告，2025年半年度母公司实现净利润30,481.07万元，加上年初未分配利润250,125.96万元，扣除2025年6月6日派发2024年度现金红利14,869.32万元，截至2025年6月30日，母公司未分配利润为265,737.71万元。2025年中期利润分配预案为：公司拟以991,287,699股（总股本扣除回购专户上已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“分红比例不变”的原则进行调整。

聚灿光电:关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及价格的公告

公司8月19日发布公告，鉴于公司2025年8月9日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》，以股权登记日总股本 680,152,346 股剔除已回购股份 32,831,660 股后的 647,320,686 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4.5 股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权及《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定：本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予数量及价格进行相应的调整。本次调整后，限制性股票预留授予数量由 306,000 股调整为 443,700 股，预留授予价格由 5.55 元/股调整为 3.83 元/股。

赛微电子:关于收购青岛展诚科技有限公司56.24%股权的公告

公司8月19日发布公告,北京赛微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)拟以15,747.20万元收购公司参股子公司青岛展诚科技有限公司(以下简称“展诚科技”、“标的公司”或“丙方”)56.24%股权。本次收购前,公司全资子公司北京微芯科技有限公司(以下简称“微芯科技”)持有展诚科技4.76%股权。本次交易完成后,公司合计持有展诚科技61.00%股权,展诚科技将成为公司控股子公司。

富信科技:富信科技董事及监事集中竞价减持股份计划公告

公司8月19日发布公告,因个人资金需求,公司董事兼副总经理洪云先生拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过61,875股,拟减持比例不超过公司总股本的0.0701%;监事王长河先生拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过21,300股,拟减持比例不超过公司总股本的0.0241%。上述减持计划将自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施。若减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项,上述股东减持股份数量将进行相应调整,减持价格根据市场价格及交易方式确定。

莱特光电:莱特光电2025年半年度利润分配方案的公告

公司8月19日发布公告,根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元(含税),不进行资本公积金转增股本、不送红股。截至2025年8月19日,公司总股本402,437,585股,扣除回购专用证券账户中股份数2,435,040股后,实际参与利润分配的股份数量为400,002,545股,以此计算合计拟派发现金红利人民币72,000,458.10元(含税),占公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为56.93%。

秋田微:关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告

公司8月20日发布公告,经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]10号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币37.18元,募集资金总额为人民币743,600,000.00元,扣除发行费用人民币(不含税)49,768,867.92元,实际募集资金净额为人民币693,831,132.08元,其中超募资金人民币19,683.73万元。募集资金已于2021年01月22日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年01月25日出具“天健验[2021]3-2号”《验资报告》,确认募集资金到账。股本、配股等股份变更事项的,将根据相关规定对拟减持数量和比例进行调整。

长电科技:长电科技2025年中期利润分配方案的公告

公司8月20日发布公告,公司拟以总股本1,789,414,570股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),共分配红利53,682,437.10元(含税),

分配后公司未分配利润结余转入下一期间。2025 年半年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将具体调整并披露。

安克创新：关于首次授予激励对象名单并向激励对象授予限制性股票的公告

公司8月20日发布公告，本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。本激励计划首次授予的激励对象总人数为 608 人，包括公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员、核心技术及业务人员(包括外籍员工)；不包括公司独立董事和单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。预留部分激励对象将于本次激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定。本激励计划拟授予的限制性股票数量为 5,246,226 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.99%。其中，首次授予 4,196,981 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.79%，占本次授予权益总额的 80%；预留 1,049,245 股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.20%，预留部分占本次授予权益总额的 20%。

信濠光电：关于持股5%以上股东部分股份拟被司法拍卖的公告

公司8月21日发布公告，持有本公司股份20,596,541股，占本公司总股本比例10.14%的大股东梁国豪先生所持有的本公司917,280股，占本公司总股本比例0.45%将被广东省深圳市龙岗区人民法院司法拍卖；本公司无控股股东、实际控制人，梁国豪先生不是本公司的第一大股东或其一致行动人，梁国豪先生本次所持有的部分本公司股份被司法拍卖不会导致本公司第一大股东发生变化，不会对本公司的正常生产经营、公司治理产生不利影响；本次司法拍卖事项存在一定的不确定性，公司将密切关注该事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

汇顶科技：关于2025年半年度利润分配预案的公告

公司8月21日发布公告，截至2025年6月30日，深圳市汇顶科技股份有限公司母公司报表中，期末未分配利润为人民币7,130,598,146.75元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户内股份1,302,172股后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税)，本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至2025年6月30日，公司总股本462,079,234股，扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份1,302,172股后剩余460,777,062股，以此计算合计拟派发现金红利69,116,559.30元(含税)。因2025年半年度公司未实施股份回购，现金分红总额69,116,559.30元占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为16.05%。

经纬辉开：关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告

公司8月21日发布公告，天津经纬辉开光电股份有限公司于2025年5月12日披露《关于股东股份减持计划的预披露公告》，公司持股5%以上股东董树林先生及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士计划自公司披露股份减持计划公告

之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易等合法合规的方式合计减持公司股份不超过1,723万股。公司于近日收到董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士出具的《关于减持股份的告知函》及《天津经纬辉开光电股份有限公司简式权益变动报告书》，获悉截至2025年8月19日，以上股东通过集中竞价的交易方式合计减持公司4,927,207股，占总股本的比例为0.85781%。本次权益变动后，董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士合计持有公司股份28,719,596股，占公司现有总股本的4.99998%，其不再是公司持股5%以上股东。

硕中科技：2025年半年度利润分配预案的公告

公司8月21日发布公告，截至2025年6月30日，公司合并报表未分配利润为人民币1,285,034,312.33元，母公司报表未分配利润为人民币144,178,832.49元。经公司第二届董事会第六次会议决议，同意公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至2025年7月31日，公司总股本1,189,037,288股，扣减回购专用证券账户中股份总数8,714,483股后的股本1,180,322,805股为基数，以此计算合计拟派发现金红利59,016,140.25元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为59.50%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

利安科技：关于公司2025年半年度利润分配预案的公告

公司8月20日发布公告，根据公司2025年半年度未经审计财务报告，截至2025年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为327,119,503.71元，母公司可供股东分配的利润为314,038,467.39元。按照母公司与合并报表中可供分配利润孰低原则，公司2025年半年度可供股东分配的利润为314,038,467.39元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者。因此，以公司现有总股本56,237,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利人民币11,247,520元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

维峰电子：关于2025年中期现金分红方案的公告

公司8月20日发布公告，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，为进一步加大投资者的回报力度，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，同时鉴于对公司未来发展的信心，公司在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2025年中期分红方案。公司以截至2025年6月30日的总股本109,893,594股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民

币 2.00 元（含税），预计派发现金股利人民币 21,978,718.80 元，不送红股，不进行资本公积转增股本。

晶瑞电材:公司 2025 年半年度利润分配预案的公告

公司 8 月 20 日发布公告，基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，为满足广大投资者的合理诉求，稳定投资者预期，更好的回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出以下 2025 年半年度利润分配预案：拟以 2025 年 6 月 30 日总股本 1,059,574,198 股扣减公司回购证券专户中的 1,887,375 股后的股本为基数，即按照 1,057,686,823 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。若公司董事会审议通过利润分配预案后至预案实施前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励行权、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整，即保持每 10 股仍派发现金红利 0.10 元（含税）。预计本次现金分红总额为 10,576,868.23 元（含税），具体以权益分派方案实施时的金额为准。

五、下周重要事件提示

表 3：下周重要会议

行业会议				
序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办单位
1	2025 世界算力网大会	8.26	深圳市	世界算力网联盟（WCNC）
2	第二十二届中国国际半导体博览会	8.27-8.29	上海市	中国半导体行业协会
3	elexcon 2025 深圳国际电子展	8.26-8.28	深圳市	elexcon 深圳国际电子展、博闻创意会展（深圳）有限公司
公司会议				
序号	公司名称	会议名称	会议时间	
1	佳禾智能	股东大会举办	2025-08-29	
2	炬光科技	股东大会举办	2025-08-29	
3	广钢气体	股东大会举办	2025-08-29	
4	民德电子	股东大会举办	2025-08-28	
5	江丰电子	股东大会举办	2025-08-28	
6	沪硅产业	股东大会举办	2025-08-28	
7	日久光电	股东大会举办	2025-08-27	
8	英力股份	股东大会举办	2025-08-27	
9	致尚科技	股东大会举办	2025-08-27	
10	福蓉科技	股东大会举办	2025-08-27	
11	超频三	股东大会举办	2025-08-26	
12	电连技术	股东大会举办	2025-08-26	
13	弘景光电	股东大会举办	2025-08-25	

14	博通集成	股东大会举办	2025-08-25
15	国力股份	股东大会举办	2025-08-25
16	唯捷创芯	股东大会举办	2025-08-25
17	南亚新材	股东大会举办	2025-08-25

数据来源: Choice, 金元证券研究所

表 4: 电子行业限售股解禁情况汇总 (单位: 万股)

股票代码	公司名称	解禁日期	解禁数量	总股本	解禁前		解禁后		限售股份类型
					流通 A 股	占比 (%)	流通 A 股	占比 (%)	
688381.SH	帝奥微	2025-08-25	800.00	24,750.00	18,354.64	74.16	19,154.64	77.39	首发原股东限售股份
688591.SH	泰凌微	2025-08-25	240.00	24,074.35	16,603.74	68.97	16,843.74	69.97	首发战略配售股份
688525.SH	佰维存储	2025-08-26	544.27	46,670.83	31,730.43	67.99	32,274.70	69.15	股权激励一般股份
301282.SZ	金禄电子	2025-08-26	748.00	15,114.00	7,213.62	47.73	7,961.62	52.68	首发原股东限售股份
603773.SH	沃格光电	2025-08-27	3.25	22,440.63	20,409.51	90.95	20,412.76	90.96	股权激励限售股份
603773.SH	沃格光电	2025-08-28	5.85	22,440.63	20,501.12	91.36	20,506.97	91.38	股权激励限售股份
002213.SZ	大为股份	2025-08-28	29.62	23,733.78	20,629.21	86.92	20,658.83	87.04	股权激励限售股份
688416.SH	恒烁股份	2025-08-29	1,714.26	8,292.94	4,809.38	57.99	6,523.65	78.67	首发原股东限售股份

数据来源: Choice, 金元证券研究所

金元证券行业投资评级标准：

增持：行业股票指数在未来 6 个月内超越大盘；

中性：行业股票指数在未来 6 个月内基本与大盘持平；

减持：行业股票指数在未来 6 个月内明显弱于大盘。

金元证券股票投资评级标准：

买入：股票价格在未来 6 个月内超越大盘 15%以上；

增持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为 5%~15%；

中性：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为-5%~+5%；

减持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为-5%~-15%；。

免责声明

本报告由金元证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被金元证券认为可靠，但金元证券不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，金元证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的信息、材料或分析工具仅提供给阁下作参考用，不是也不应被视为出售、购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请。该等信息、材料及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，金元证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

金元证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。金元证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。金元证券的自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

在法律许可的情况下，金元证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到金元证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

本报告的版权仅为金元证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。